

# ASSEMBLY & SOLDERING TECHNIQUE

Investment :  
RP. 6.500.000,-

MGF-MATSUSHITA GOBEL INSTITUTE, 14-15 FEBRUARI 2018 ; 08.30-16.00 WIB

## Tujuan Pelatihan :

- Mengetahui dan memahami prinsip dasar teknik menyolder dan alat-alat untuk menyolder.
- Agar dapat menilai hasil penyolderan yang baik dan yang jelek.
- Mengembangkan keterampilan menyolder serta cara mengassembly part pada PCB dengan benar.

## Sasaran/ Target :

- Mampu mencapai standard Klas 3 Kategori PCB Assembly & Soldering.

## Peserta :

- Operator Line, Leader Line, dan Supervisor Line/ Teknisi.

## Materi Pelatihan :

### Hari-1 :

#### **Basic Theory of Soldering Technique**

Teory dasar untuk tehnik solder.

#### **Practical of Soldering Technique**

Memulai solder dan membiasakan diri dengan solder.

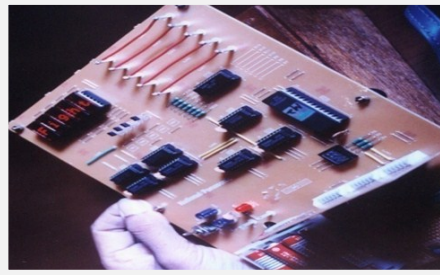
### Hari-2 :

#### **Assessment Solder**

Standard menilai hasil solder.

#### **Practical of Soldering Technique with Assembly Part**

Trik dan Tip teknik melakukan assembly part pada PCB dan menyolder.



## Metode Pelatihan :

- **Practical of Soldering Technique :** Yaitu mempraktekkan metode atau cara menyolder yang efektif dan efisien.
- **Practical of Assessment Solder :** Yaitu melakukan penilaian dengan cara menilai hasil solderan berdasarkan standard yang tersedia.
- **Practical of Assembly Technique :** Yaitu melakukan assembly dengan mempraktekkan metode atau cara untuk merakit part pada PCB yang tersedia agar rapi dan terhindar dari kerusakan.



TRAINING & CERTIFICATION

## Registration :

### **S. Agung Hariadi**

MGF-Matsushita Gobel Institute  
Jl. Raya Bogor Km. 29, Jakarta 13710  
Phone : (+62-21) 8725603 ; Fax : (+62-21) 8717864  
Email : s.agunghariadi@mgf.or.id